

HY600 系列 Series

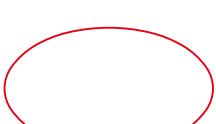
导热界面材料

Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料

Special Design for Electronic Components Heat Transfer

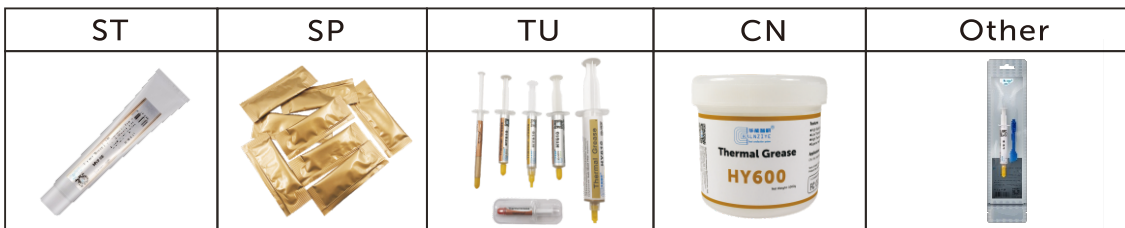
项目 Items	HY610	HY620	HY630	HY650	单位 Unit
颜色 Color	金色 Gold	金色 Gold	金色 Gold	金色 Gold	No
热传导系数 Thermal Conductivity	3.05 ~ 3.76				W/m-k
热阻抗 Thermal Impedance	<0.073	<0.051	<0.038	<0.018	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	2.33	2.33	2.33	2.33	g/cm ³
浓度 Thixotropic Index	350±10	350±10	350±10	350±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-30-220	-30-220	-30-220	-30-220	°C
工作温度 Operation Temperature	-20-180	-20-180	-20-180	-20-180	°C



成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	30%	25%	20%	15%	%
碳化合物 Carbon Compounds	20%	20%	20%	20%	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	50%	55%	60%	65%	%
包 装 Package	软管 ST	迷你包 SP	针管 TU	罐装 CN	吊卡 Other
	20g-100g	0.5g-5g	0.5g-30g	10g-1000g	0.5g-5g

产品图片 Products Pictures



执行标准: Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温, 阻燃, 一般常温储存方式即可

Thermal Interface Materials Temperature Resistant, Flame Retardant and Storage at room temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得, 该实验室保留最终解释权

All data above are provided Shenzhen Halnziye Electronics Co.,Ltd. Halnziye All Rights Reserved